

**2022 年度第 1 四半期 WEB 決算説明会（2022 年 11 月 11 日開催）****およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【受注高】****1. 受注高は 666 億円と引き続き高水準だが、社内計画に対してはどうだったのか？事業毎に見るとどうか？2Q 以降はどのような見込みか？**

A: 受注高はほぼ予定通り。2 Q以降も電子分野を中心に高水準の受注を見込む。

半導体電子は、①パワーデバイスが中国大口案件・日本の投資増加により大きく伸び、電子は 2Q 以降も引き続き好調に推移する見込みで、②半導体は足元のメモリ投資抑制や米国の中国半導体規制の影響を受けて不透明感があるものの、新規顧客との取引開始、新規工程参入など中長期的な成長の芽が育っている。半導体電子の 1Q 受注高は四半期ベースでは過去最高水準となった。

FPD は、前年度に活発化した IT パネル用 LCD 投資の反動減もあり今年度は端境期となる見込み。Q によって凸凹はあるが、上期受注はほぼ予定通りとなると見込んでいる。

コンポーネントは、部品長納期化に伴うセットメーカーなどからの前倒し受注もあり高水準。

**【売上高・利益(率)、部材調達関連】****2. 売上総利益率 29.3%は前年度 4Q 比減少しているがなぜか？社内計画に対して売上高・営業利益(率)の進捗はどうか？2Q 以降、利益率は改善するのか？**

A: 前年度 4Q 比売上総利益率が減少したのは、売上高減少による。

部材長納期化の影響等により売上高の進捗が計画比、若干届かず、営業利益も下回った。加えて、部材長納期化・部材コスト上昇の影響によりモノづくり力強化による利益率改善効果が抑制されていることも影響して利益率は計画を下回った。

2 Q 以降は、①高水準の受注高に支えられ 650 億円前後の売上高となる見込みであり、売上高増加に伴い利益率が改善する見込みであること、②下期には利益率水準の高い半導体電子の売上比率が高まり、ミックスが改善すること、③部品の長納期問題も下期には徐々に緩和してくるものと思われ、モノづくり力強化の取組みの効果が徐々に回復してくるものと見込まれることから、利益水準・利益率は改善してくるものと考えている。

**3. なぜモノづくり力強化による利益率改善が抑制されているか？**

A: モノづくり力強化による利益率改善は 21 年度 3Q から部材長納期化により、①長納期部材の調達を優先せざるを得ず、標準化・部品共通化等によるボリュームコストダウン交渉が難しくなっていることや②生産工程の組み直しや納品後の追加インストールが必要となるなど、モノづくり力強化で取り組んできた生産性改善の効果が出にくくなっている。部材長納期問題は下期にかけて徐々に緩和してくるものと思われ、モノづくり力強化の取組みの効果も徐々に回復してくると見込まれることから、利益水準・利益率は改善してくるものと考えている。

**4. どのような部材が長納期化しているのか？どのような対策を取っているのか？**

A: 電子部品の入手難が続き、長納期が部品から製品に範囲が拡大し継続している。  
基板を搭載する制御系部品全般や電源、マスマイクコントローラー、通信ボードなどが長納期化しており、調達リードタイムは最長 1 年超になり、納期回答が難しい製品もでてきている。  
部品・材料の先行手配やサプライヤーの原材料手配協力、標準ユニットの早期部材確保、各メーカーとの定期的な打合せによる協力体制などに加え、海外グループ連携によるグローバルな部品確保の取組などを実施している。  
また、取引先や一部の顧客とも入手困難な部品情報を共有し、協力して部品確保に取り組んでいる。さらに仕様変更による部品置き換えも進めている。

**5. 装置のリードタイムはどの程度伸びているのか？**

A: 装置によっても異なるが、例えば半導体・電子では、様々な対応により 6 ～ 8 ヶ月程度に抑え込んでいたリードタイムが、部材の長納期化に伴い、1 年を超えるようになってきている。

**6. 部材調達コスト上昇、物流コスト上昇による影響は？**

A: 部材調達コストや物流コストの上昇については、当社の装置ビジネスは、見積りごとに価格交渉を行うケースが多いことから、これまで、都度の価格交渉で吸収できてきたが、例えばパネルメーカーは収支状況が厳しいこともあり、価格交渉がシビアになってきており、必ずしも吸収しきれないケースも出てきている。モノづくり力強化による利益率改善の効果も部材長納期化によって抑えられている。  
物流コストは、顧客に製品を届ける際の物流費は、FOB 等が多く顧客負担となるため、影響は比較的軽微である。

**7. 1Q の半導体電子部品および FPD の受注高・売上高の用途別内訳は？**

A: 別紙のとおり。

**8. 1Q の営業利益率順位は？**

A: 別紙のとおり。

**【半導体電子】**

**9. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？**

A: メモリ・ロジックなどの半導体については、中国半導体メーカーへの従来取引はそれほど大きくなく、既存取引への影響は限定的。  
今年度から新規取引開始を期待していたものが一部あり、最大 50 億円程度の影響がある可能性があり確認中。  
中国ビジネスで成長を見込んでいるパワーデバイスや各種電子デバイスに関しては、米国の半導体規制の影響は特になく、パワーデバイス等電子関連が好調なため、カバーできる。

**10. メモリ等半導体関連の投資が 23 年にスローダウンするのではないかとの見方が多い中、アルバックの受注にはどのような影響が考えられるか？**

A: メモリ・ロジックで上期から下期への期入れも発生しており、減速感を感じている。ロジックのメタルハードマスク(MHM)工程への参入がキッカケとなり、ロジックのみならずメモリ分野でも他工程への参入のチャンスが広がり、実際に他工程参入が実現し始めるとともに、新規顧客との取引も開始するなど、中長期的な成長の芽も出始めている。

**11. 1Q のパワーデバイス受注は 100 億円を超え四半期ベースで過去最高水準だったと思うが、地域別・装置別・方式別 (IGBT/SiC) でどのようなウェイトだったのか？**

**2Q 以降も引き続き好調に推移するのか？**

A: 22 年度 1Q のパワーデバイス受注は、地域別でみると、SiC の大型受注が入った中国のウェイトが 6 割を超えた。日本の投資も増加しており 2 割強だった。1 割程度は台湾の投資だった。中国では SiC 向けイオン注入装置のウェイトが高く、日本では IGBT や SiC 向けのスパッタ装置が中心。1Q は中国の 40~50 億円程度の大口案件が寄与したため突出して高くなったが、2Q 以降も日本・中国中心に高水準の受注が期待できる。

**12. オプトデバイス、電子部品等の投資動向について教えてほしい。**

A: 1Q に AR/VR 用μOLED の大型案件を受注し、2Q 以降にも別の顧客からμOLED の受注を予定している。またμOLED 以外でも日本の電子部品メーカーからの増産投資を受注し、各種電子デバイス関連の受注も高水準。2Q 以降も日本・中国の増産投資・技術革新投資が継続する見込み。

**【FPD】**

**13. LCD 投資は継続してあるのか？ FPD の今期受注はどのようにみているのか？**

A: LCD パネル価格が下落しており、昨年度に比べると投資は大きく減少することを織り込んだ受注計画となっている。車載用など IT パネル向け LCD は中国企業同士で生産性・価格の競争が激しくなっており、生産性向上のための大型ガラス基板 (G8.6) 投資が継続している。スマートフォン用 G6・OLED パネルの生産性向上や高精細化改造投資が中国・韓国・日本で継続。また、韓国や中国のトップメーカーによる IT パネル用大型基板 OLED 投資に向けて、G8.5 枚葉型スパッタ装置を当社韓国工場に設置し、サンプリング等を行って量産に向けた低パーティクルなど優位性の確認をしてもらっている。量産投資は今年度後半から来年度にかけて実現し始めると考えている。

以上

別紙：品目別実績 内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	FY2022 1Q
<b>半導体電子（億円）</b>	<b>293</b>
・メモリ	2割弱
・ロジック	1割半ば
・電子部品	2割半ば
・パワー半導体	約4割
・実装	数%
<b>FPD（億円）</b>	<b>99</b>
・LCD	3割半ば
（大型向け割合）	（大型向け100%）
・OLED	6割強
・その他	数%

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	FY2022 1Q
<b>半導体電子（億円）</b>	<b>171</b>
・メモリ	3割強
・ロジック	1割強
・電子部品	2割半ば
・パワー半導体	約2割
・実装	1割強
<b>FPD（億円）</b>	<b>164</b>
・LCD	5割強
（大型向け割合）	（大型向け7割）
・OLED	4割強
・その他	1割弱

●営業利益率順位 FY2022 1Q

順位	品目
1	コンポーネント
2	半導体電子
3	一般産業
4	FPD
5	その他
6	材料

全社平均利益率は  
 2) 半導体電子と  
 3) 一般産業との間